

摺動接点に欠かせない耐摩耗性を誇る金めっき



使用頻度の激しい携帯電話の接点に耐摩耗性を確保。

コバルト・ニッケルなどの添加剤の共析物を得ることで、金の特性である**電導性・不変性**はもとより、**硬さや耐摩耗性を高めた鏡面光沢金合金めっき**です。優れた**耐食性**を有し、**接触性能、はんだ付け性**にも秀でています。コネクタ、電気接点部品、プリント配線基板等の電子部品工業用に用いられています。

■スペック

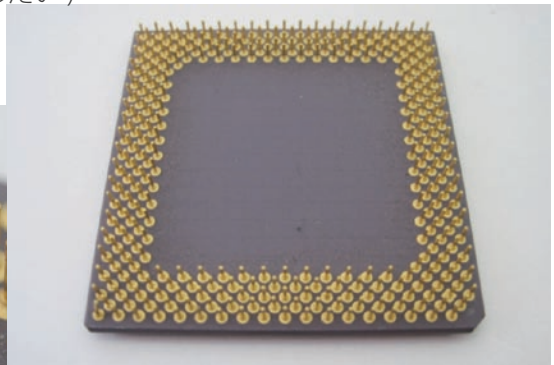
金 (Au)	98.5 ~ 99.5wt%
コバルト (Co)	0.5%~
膜厚	0.1 μm~5.0 μm
硬度 (ヌーブ)	200 ~ 240
電気抵抗	1.05 × 10 ⁻² (Ω/cm ²) (三菱ケミカル oresta-EPMCP-T360)
半田付け	良好
ボンディング	良好
耐熱性	変退色なし (200℃ 24 時間)

耐食性: 金の特性で、加熱時にも酸化せずに性能を維持します。
耐摩耗性: コバルト・ニッケルなどの添加剤の共析物を得て、硬度を高めています。
電導性: 金の特性として、極めて高い電導性を有します。
半田付け性: 添加物が入っても、もともとの金の特性である半田付け性への影響はほとんどありません。
ボンディング性: 添加物が入っても、もともとの金の特性であるボンディング性への影響はほとんどありません。

■応用例

加熱時においても酸化・変色を避けたい部品

- ・摺動摩耗部の接点・電子機器のスイッチの接点部分 (電導性と硬度を両立させたい)
- ・コネクタ・ピン・IC ヘッダー・リードスイッチ、携帯電話等の通信機器 (電導性と耐摩耗性を確保したい)
- ・ロータリースイッチ・接点バネ (電導性と半田付け性を確保したい)
- ・リードフレーム (電導性とボンディング性を確保したい)
- ・スリップリング (電導性と摺動性を確保したい)



金の特性を活かしつつ、耐摩耗性を高めました。